リン処理を施した SiC MOSFET におけるチャネル移動度の ボディ層アクセプタ密度依存性

Dependence of channel mobility on doping concentration of p-body in POCl3-annealed SiC MOSFETs

京大院工1,名大院工2, ○伊藤 滉二1, 堀田 昌宏1,2, 須田 淳1,2, 木本 恒暢1 Kyoto Univ. 1, Nagova Univ. 2, °Koji Ito1, Masahiro Horita1, 2, Jun Suda1, 2, Tsunenobu Kimoto1 E-mail: ito@semicon.kuee.kyoto-u.ac.jp

背景・目的: SiC MOSFET では、高密度界面準位 (Di) の存在により、ゲート電圧に伴って、可 動電子移動度と D_{it}に捕獲された電子密度が同時に変化する複雑さから、移動度制限要因の議論が 困難となっている。この問題に対し、MOS Hall 効果測定から可動電子移動度を評価する方法[1,2]、 もしくは D_{it} の影響を極力低減した MOSFET の I-V 特性からチャネル移動度を評価する方法が方 策として挙げられるが、後者に関する先行研究はほとんど存在しない。そこで、Ditを大幅に低減 $(D_{it} < 10^{11} \text{ cm}^{-2} \text{eV}^{-1})$ できる界面処理法であるリン処理 (POCl₃, O_2 , N_2 の混合ガスアニール) [3]に 着目した。本研究では、ボディ層アクセプタ密度 (NA) を系統的に変化させた SiC n チャネル MOSFET を、リン処理を施して作製した。ゲート特性を中心に測定を行い、チャネル移動度を評 価することで、SiC MOSFET の移動度制限要因の議論を試みる。

試料作製:MOSFET のゲート酸化膜は、p型 4H-SiC (0001) 面試料に熱酸化 (1300℃, 30 分)+窒化 処理 (NO 雰囲気 1250℃, 70 分)、もしくは熱酸化+リン処理 (POCl₃, O₂, N₂雰囲気 1000℃, 10 分 + N_2 雰囲気 1000° C, 30 分) を施し作製した。酸化膜厚はそれぞれ 42,58 nm であった。ボディ層アク セプタ密度はAlイオン注入を施すことで 3×10^{15} - 3×10^{18} cm⁻³の広範囲で系統的に変化させた。

結果・考察: Figure 1 にリン処理を施した MOSFET における電界効果移動度 (μ_{FE}) のゲート電圧 依存性を示す。 $N_A = 3 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ の MOSFET では $\mu_{FE} = 132 \text{ cm}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1}$ でピーク値を取るのに対し、 $N_{\rm A}=3\times10^{18}~{
m cm^{-3}}$ の MOSFET では $\mu_{\rm FE}=8~{
m cm^2V^{-1}s^{-1}}$ 程度であることがわかる。続いて、Figure 2 に 窒化処理およびリン処理を施した MOSFET における電界効果移動度のピーク値のボディ層アク セプタ密度依存性、および実測した Hall 移動度 (μ_{Hall}) のピーク値を、窒化処理を施した MOSFET における Hall 移動度の報告値[2]とともに示す。リン処理を施した MOSFET に関しては、 $N_A=3$ $imes 10^{15}~\mathrm{cm^{-3}}$ において、 $\mu_{\mathrm{FE}} = 132~\mathrm{cm^{2}V^{-1}s^{-1}}$, $\mu_{\mathrm{Hall}} = 144~\mathrm{cm^{2}V^{-1}s^{-1}}$ であった。これは、リン処理を施し た MOSFET においては、キャリアトラップ効果が小さいことを示唆している。しかしながら、 N_A $<3\times10^{17}\,\mathrm{cm^{-3}}$ の範囲では $\mu_{\mathrm{FE}}=82\text{-}132\,\mathrm{cm^{2}V^{-1}s^{-1}}$ と比較的高移動度を維持しているのに対し、 $N_{\mathrm{A}}>$ $1 \times 10^{18} \, \text{cm}^{-3}$ の範囲では、 $\mu_{\text{FE}} = 8 - 36 \, \text{cm}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1}$ 程度まで減少している。それでもなお、窒化処理を 施した場合と比べると、リン処理を施した場合は、広いボディ層アクセプタ密度の範囲において 高い電界効果移動度を有することがわかる。また、(0001)面にリン処理を施した MOSFET におけ るチャネル移動度のボディ層アクセプタ密度依存性は、(11**2**0)および(1T00)面に窒化処理を施した 場合[4]と概ね一致している。続いて、先行研究における窒化処理を施した MOSFET での Hall 効 果測定結果[2]と比較する。Hall 移動度の報告値[2]は実測結果と概ね整合しており、窒化処理の条 件に大きな差異が無いことがわかる。その結果、例えば $N_A = 1 \times 10^{17}$ cm⁻³ の窒化 MOSFET におけ る Hall 移動度は高々 $\mu_{\rm Hall}$ = 30 cm 2 V $^{-1}$ s $^{-1}$ であるのに対し、本研究で作製したリン処理 MOSFET の 場合は最大で μ_{FE} = $103~cm^2V^{-1}s^{-1}$ となっている。したがって、窒化処理の場合に支配的となってい る散乱要因がリン処理の場合では除去できている可能性が示唆される。

[1] T. Hatakeyama et al., Appl. Phys. Express 10, 046601 (2017). [3] D. Okamoto et al., IEEE Trans. Electron Devices 31, 710 (2010).

[2] M. Noguchi et al., IEDM Tech. Dig. (2017), p. 219. [4] S. Nakazawa et al., IEEE Trans. Electron Devices **62**, 309 (2015).

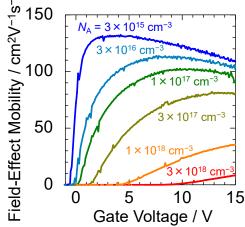


Fig. 1 Gate voltage dependence of field-effect mobility for POCl₃-annealed MOSFETs with various doping concentrations of the p-body.

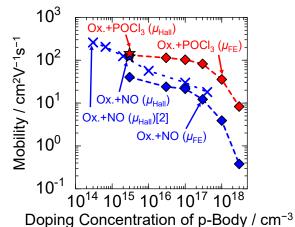


Fig. 2 Dependence of mobility on doping concentration of the p-body in NO-annealed and POCl3-annealed MOSFETs.